

INFORMAȚII PERSONALE

Liviu Marin Viman

0264 401469  Liviu.Viman@ael.utcluj.ro

Sexul Masculin | Data nașterii 24/05/1975 | Naționalitatea Română

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ2016 - prezent
2011 – 2016
2001 – 2011
1998 – 2001

Conferențiar universitar la Departamentul de Electronică Aplicată

Șef de lucrări la Catedra de Electronică Aplicată

Asistent la Catedra de Electronică Aplicată

Preparator la Catedra de Electronică Aplicată

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului , nr. 28, Cluj-Napoca

Principalele activități și responsabilități: *Activități didactice și de cercetare*

- Titularul cursurilor:
 - ✓ **Sisteme de Achiziții de Date (Ro, Eng)**, Specializarea: Electronică Aplicată, Anul: IV
 - ✓ **Electronică Aplicată (Ro, Eng)**, Specializarea: Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Anul: IV
 - ✓ **Bazele Sistemelor de Achiziții de Date (RO)**, Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic, Anul: III
- Alte discipline predate anterior:
 - ✓ Tehnologia Microsistemelor Electronice
 - ✓ Sisteme de Conversie și Achiziție de Date
 - ✓ Echipamente Periferice

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2002 – 2009

Diplomă de doctor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

- Domeniul: Inginerie Electronică și Telecomunicații
- Titlul tezei: Cercetări teoretice și experimentale privind sistemele de achiziție și prelucrare a semnalelor

1998 – 1999

MSc Diploma

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică și Telecomunicații

- Specializare: Compatibilitate electromagnetică în sisteme și aparate electronice

1993 – 1998

Diplomă de inginer în electronică și telecomunicații

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică și Telecomunicații

- Specializare: Electronică

- Iunie 1998 **Certificat pedagogic**
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică și Telecomunicații
- Discipline: Psihologia școlarului, Pedagogie, Practică pedagogică, Metodica specialității
- 1989 – 1993 **Diplomă de bacalaureat**
Grup Școlar Industrial Poștă și Telecomunicații, Baia-Mare
- Specializare: poștă și telecomunicații
- 2009 **Certificat de instructor IPC**
Certificare internațională de instructor IPC („Certified IPC Trainer”) în domeniul tehnologiei electronice pentru standardul IPC-A-610, Serial no. 610-T 41273

ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

- 2017 - prezent **Membru în comisia de admitere master**
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
- 2015 - 2016 **Responsabil coordonator al contractului de colaborare Higher Education Program (HEP) având ca parteneri UTCN și TRIAS Mikroelektronik GmbH, distribuitor autorizat pentru Mentor Graphics Software**
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
- 2011 - prezent **Membru în comisia de finalizare a studiilor – licență și master**
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
- 2010 - prezent **Consilier de an pentru anul IV specializarea Electronică Aplicată cu predare în limba engleză**
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
- 2001 - prezent **Coordonator al comitetului local al concursului profesional studentesc (TIE și TIEplus) Tehnici de interconectare în electronică (Design of Electronic Modules & Assemblies), coordonator al echipelor de studenți care participă anual la concursul TIE și TIEplus,**
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Membru în comitetul științific

- 2015-prezent **INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE, ISBN 973-713-063-4, Website: <http://conf.cunbm.utcluj.ro/index.php/iis/iis2015>**

- 2017-prezent Simpozionului Studențesc de Electronică și Telecomunicații - SSET – Facultatea de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, Website: https://etti.utcluj.ro/files/Acasa/Site/SSET/1_Color_Brosura2023.pdf.
- 2018-prezent IEEE International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), ISBN: 978-1-5386-1627-7, Website: <http://siitme.ro/2020-edition/committees/>.

Membru în comitetul tehnic

- 2001 – prezent TIE – Tehnici de interconectare în electronică (Design of Electronic Modules & Assemblies) – Concurs profesional studențesc . Website: <http://www.tie.ro>.
Co-Chairman al comitetului tehnic.

Reviewer

- 2018 – prezent Energies (ISSN: 1996-1073); (I.F=3.252 , Website: <https://www.mdpi.com/journal/energies>, Q1 ranking
 Electronics (ISSN 2079-9292; CODEN: ELECGJ), I.F=1.764, Website: <https://www.mdpi.com/journal/electronics>, Q1 ranking
 Processes (ISSN 2227-9717; CODEN: PROCCO), I.F=1.963, Website: <https://www.mdpi.com/journal/processes>, Q2 ranking
 Applied Sciences (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7), I.F=2,474, Website: <https://www.mdpi.com/journal/applsci>, Q1 ranking
 Sensors (ISSN 1424-8220; CODEN: SENSC9), I.F=3,275, Website: <https://www.mdpi.com/journal/symmetry>, Q2 ranking
 JMSE (ISSN 2077-1312), I.F=2,033, Website: <https://www.mdpi.com/journal/jmse>, Q2 ranking
- 2018 ACTA TECHNICA NAPOCENSIS ELECTRONICA-TELECOMUNICATII (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS), ISSN 1221-6542, Volume 59, number 1, march 2018 - Website: <http://users.utcluj.ro/~atn/>
- 2017 – prezent IEEE International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Website: <http://siitme.ro/2018-edition/committees/>
- 2015 – prezent Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering ISSN: 2332-3280, Website: http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=49

Membru în comitetul de organizare

- 2021 TIE – Tehnici de interconectare în electronică – Concurs profesional studențesc, Ediția XXX, Octombrie 25-26, Cluj-Napoca, Romania. **Chairman** al concursului. (www.tie.ro)
- 2019 IEEE International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages” (SIITME), Septembrie 23-26, 2019, Cluj-Napoca, Romania,
- 2010 TIE – Tehnici de interconectare în electronică (Design of Electronic Modules & Assemblies) – Concurs profesional studențesc, Ediția XIX, Aprilie 14-17, 2010, Cluj-Napoca, Romania
- 2007 30th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), Mai 9-13, 2007, Cluj-Napoca, Romania
- 2005 International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages” (SIITME), Septembrie 22-25, 2005, Cluj-Napoca, Romania
- 2004 TIE – Tehnici de interconectare în electronică (Design of Electronic Modules & Assemblies) – Concurs profesional studențesc, Ediția XII, Mai 21-23, 2004, Cluj-Napoca, Romania

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă Română

Alte limbi străine cunoscute

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	
Engleză	B2	B1	B1	B2	B1

Certificat de competență lingvistică

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

[Cadrul european comun de referință pentru limbi străine](#)

Competențe de comunicare

- bune competențe de comunicare dobândite prin experiența de predare, prin cea de coordonare în contractele de cercetare și datorită muncii în echipă

Competențe organizaționale/manageriale

- leadership
 - director al unui contract de cercetare internațional
 - manager de proiect și team leader în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologia Informației în Electronică (ITEC), direcția de cercetare Embedded Systems pentru Automotive
 - coordonator și responsabil de fază în cadrul centrului de cercetare ITEC, contract internațional cu partener CONTI TEMIC MICROELECTRONIC GMBH și contract național cu partener Continental Automotive Romania SRL
 - coordonator/responsabil tehnic al Laboratorului Proiectare și Testare Sisteme Embedded de Viteză Mare, Sisteme de Putere și Senzori Inteligenți
 - coordonare echipe de studenți participante la concursul TIE – Tehnici de Interconectare în Electronică

Competențe tehnice

- proiectare și integrare sisteme de achiziție de date utilizate la monitorizarea construcțiilor hidrotehnice
- proiectare și integrare sisteme de achiziție de date și data logger utilizate la monitorizarea și măsurarea energiei electrice
- dezvoltare și implementare sisteme embedded și data logger pentru domeniul biomedical, biotehnologic sau al industriei farmaceutice
- dezvoltare de sisteme HIL (Hardware-in-the-Loop) utilizate pentru testare în industria de automotive

Competențe informatice

- proiectarea și simularea circuitelor electronice utilizând pachete informatice specializate (Matlab, Pspice, PSim, etc.)
- proiectarea și analiza plachetelor electronice utilizând programe de proiectare asistată de calculator (OrCAD, Mentor Graphics, Eagle, Altium, Zuken, etc.)
- o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™
- o bună cunoaștere a limbajelor de programare: C/C++, VHDL și a mediului de programare grafică LabView

Alte competențe

- spirit de echipă
- adaptabilitatea la medii multiculturale
- abilitatea de a munci în condiții de stres psihic și emoțional
- creativitate

**INFORMATII
SUPLIMENTARE**

- Publicații**
- 1 teză de doctorat
 - 2 cărți
 - 5 manuale didactice
 - 3 articole în reviste indexate ISI (1 articol ISI zona roșie IF=3.275 – Sensors, MDPI, și 1 articol ISI zona galbena IF=3.160 – Healthcare, MDPI)
 - 22 articole în volumele unor manifestări științifice indexate ISI proceedings
 - 5 articole în volumele unor manifestări științifice indexate BDI
 - 22 de articole publicate în reviste sau în volumele unor manifestări științifice naționale/internaționale neindexate
- Contracte de cercetare**
- director al unui contract de cercetare internațional
 - membru în 9 granturi/proiecte de cercetare internaționale și în peste 50 de granturi/proiecte naționale
- Afilieri**
- IEEE membru
 - IEEE Electronics Packaging Society